

株式会社 アルバック

2024年6月期第2四半期 WEB 決算説明会（2024年2月13日開催）およびアナリストミーティングの主な質疑応答

【受注高】

1. 上期受注高実績は前年同期・当初計画を上回ったのに対し、下期は下がる見込みとなっているのはなぜか？

A: 日本・中国の SiC パワーデバイス投資、バッテリー関連のアルミ両面蒸着膜向け投資が上期、特に 1Q に集中した。当初計画時より上期に集中することを想定しており、下期は下がる見込みだった。

日本でもパワーデバイスの SiC 投資がよいよ本格化したが、1Q は 6 インチウエハ中心で、今後は 8 インチ化を進めようとしている。今下期・来期前半は 8 インチのパイロットライン投資中心で日本のパワーデバイス投資は落ち着いたものになり、来期後半から 8 インチの本格量産投資が活発化すると見込んでいる。また、中国のパワーデバイス投資も正月・春節の影響で商談ペースが落ちることもあり、下期の水準は低下すると見込んでいるが、来期以降はまた活発な投資が継続すると見ている。

EV バッテリーの小型大容量化・安全性向上に向けた正極集電体のアルミ箔からアルミ両面蒸着膜への切り替えのための第一次投資が 1Q に本格化した。各社とも第一次投資した装置の稼働確認後、第 2 次以降の積極投資計画を持っており、来年度以降、さらに成長すると見込んでいるが、今下期は落ち着いた動きとなる。

パワーデバイス・バッテリー関連共に上期特に 1Q に集中し、下期は一時的に低下するが、来期以降、更なる成長を見込んでいる。

2. 下期受注は上期比減少見込みだが、来期以降をどのように見込んでいるのか？

A: 成長ドライバーを中心に来期以降も受注増加を見込んでいる。成長ドライバーの受注高は 26/6 期は 23/6 期の 1.6 倍以上を見込んでおり、26/6 期の連結受注高は 3,000 億円以上を見込んでいる。

3. 成長ドライバーの足元の投資動向、来期以降の受注見込みについて、それぞれ教えてほしい。**A: ① パワーデバイス**

SiC 投資が活発だった中国に加え、日本でも 6 インチの SiC 投資が始まった。

国内各社は 8 インチ化を検討しており、パイロットラインを経て来期後半以降、本格投資開始を見込んでいる。

グリーンエネルギー化・EV 化による需要増、SiC 投資の活発化、ウエハーサイズアップ、トレンチ構造化などに伴うビジネスチャンスが中長期的に拡大している。来期は横ばい程度か若干の減少となる見込みだが、26/6 期はさらに増加し、23/6 期比 1.5 倍程度に成長する見込み。

② 各種電子デバイス

各種電子デバイスは、技術革新や増産投資が継続している。

AR/VR 用 μ OLED 投資が継続するとともに、微細化に限界が見え始めている中、省エネ対応のためのパッケージング投資が活発化してきており、受注拡大に期待している。

ウエハーレベルパッケージングでは最先端プロセスに対応したアッシング装置に強みがある。パッケージング用のアッシング装置は TSMC でも表彰いただいた。今後はスパッタリング装置も拡販していく。今後はウエハーレベルに加えパネルレベルパッケージングも投資が本格化する見通しで、既に台湾・日本の主要メーカーにアッシング装置の実績があり、スパッタ

リング装置と共に拡販していく。パッケージングの 26/6 期は 23/6 期比 4.4 倍程度に成長する見込み。
各種電子デバイス全体の 26/6 期は 23/6 期比 1.2 倍程度に成長する見込み。

③ メモリ

メモリ投資は在庫調整局面から投資回復局面にシフトしていく。今期は HBM 関連投資が一部寄与した。DRAM 中心に下期より投資が回復すると考えている。

④ ロジック

先端ロジック投資も調整局面から投資回復局面にシフトしていく。特に MHM 工程で北米ロジックメーカーで 3 社目としての採用が確定したので、今後は MHM 工程に加えて新たな工程でも成長していきたい。昨年度、新規に取引を開始した北米レガシーメーカーからも継続受注が見込まれ、ロジック分野の取引基盤が拡大してきている。

⑤ バッテリー

EV バッテリーの正極集電体のアルミ両面蒸着膜への第一次投資が 1Q に本格化した。第 1 次投資した装置が下期から順次稼働し始めるがその稼働状況を確認した上で、各社とも次なる成長投資計画に取組もうとしており、来年度以降、更なる成長を見込んでいる。26/6 期は 23/6 期比 4.7 倍程度に成長する見込み。

4. EV 需要の伸びが鈍化しているとも言われる中、パワーデバイス・バッテリーの投資トレンドはどのようなになるのか？

A: 日本のパワーデバイス投資は、上期は 6 インチ SiC 投資が活発化、下期以降は 8 インチ SiC 投資に向けたパイロットラインでの受注を見込み、本格的な 8 インチ SiC 投資は量産化目途が立つ来期後半以降に活発化すると見込んでいる。また SiC 構造がプレーナからトレンチに変化することにより、エッチング装置でのビジネスチャンスが拡大する。パワーデバイス投資全体としては、一時的に下期以降、投資が落ち着くが、来年度後半以降、投資が活発化すると見込んでいる。

中国のパワーデバイス投資は、中国国産化方針のもと、地方政府の各種優遇策等も後押しする形で、国産化のための量産投資が継続している。下期は正月・春節を挟み商談ペースが落ちることもあり、下期受注は上期に比べると落ち着く見込みだが、来期以降、6 インチ SiC 投資に加えて、8 インチウエハーサイズアップ投資など、活発な投資が継続する見込み。

バッテリーについては、安全性向上・小型軽量化を目的として、従来使われている正極集電体のアルミ箔からアルミの両面蒸着膜への置き換え需要であるため、EV 化が減速しても投資は伸びていくと見込んでいる。

アルミ両面蒸着膜投資はまだ第一次投資の段階で、第 1 次投資した装置が下期から順次稼働し始めるが、各社とも、装置稼働状況を確認の上、次なる成長投資計画に取組もうとしている。来年度以降、更なる成長を見込んでいる。

今後の差別化・ビジネスとしての成長という観点では、更なる生産性向上のためのフィルム横幅の広幅化にも取り組んでいる。また、負極集電体を、従来の銅箔から銅の両面蒸着膜に置きかえるための両面蒸着巻取装置の開発にも取り組むなど、更なる成長に向けた開発も進めている。

5. パワーデバイスの上期受注は 200 億円超と高水準だが、方式別・地域別・装置別でどのようなウエイトだったのか？

A: 上期パワーデバイス受注は、方式別でみると 8 割半ばが SiC 関連投資で、1 割が Si-MOSFET 関連投資で、数% が IGBT 関連投資だった。地域別でみると、中国のウエイトが 6 割で日本が 4 割。

装置別ではイオン注入装置が約 6 割、スパッタ装置が約 3 割、残り 1 割が Si-MOSFET 向け蒸着装置。

日本でも 6 インチ SiC 向けイオン注入装置を受注しており、今後、8 インチ化が展望される中、日本でのイオン注入装置ビジネス展開にも力を入れていきたい。

6. 中国での半導体関連のビジネスチャンスはどうなっているのか？

A: 中国の半導体関連は、アルバックはレガシーノードでの採用実績が少ないことから、他社のようなウエイトの受注にはならないが、徐々に伸ばしていきたい。計画としてはそれほど大きな金額で織り込んではいない。

7. 米国による中国半導体輸出規制等の影響は？パワーデバイス等に影響は無いのか？

A: 中国の半導体関連は計画としてはそれほど大きな金額で織り込んではいない。ビジネスが拡大しているパワーデバイスや各種電子デバイス、バッテリー関連は規制の対象外でビジネスへの影響はない。むしろ先端半導体投資に制約がある中、パワーデバイス等に対する投資により力が入ってきている感もあり、パワーデバイス等の投資は活発化している。

【売上高・利益（率）】

8. 上期は売上高・営業利益が計画を上回ったが、下期はどうなるのか？通期業績予想を変更していないが上振れるのか？

A: 上期売上高は工事進行基準の売上計上が当初計画より早まって上回った影響が大きい。下期は上期比売上増となるが、増加幅は穏やかなものとなる見込み。上期と比較すると下期は売上増加効果で売上総利益率・営業利益率ともに改善する見込みである。販管費は下期が高くなる傾向にあり、通期営業利益はほぼ計画並みを見込む。

9. 下期に販管費が増加する傾向にあるのはなぜか？

A: 研究開発費の増加や受注増加に伴う販売費増加等による。

10. リードタイムについて、主な事業別・分野別・製品別に教えてほしい

A: 顧客への納期リードタイムという点では、ロジック・メモリ向けスパッタ装置は、計画的生産の効果もあり、3～5ヶ月、電子デバイス関連で、先行手配で動いているスパッタ、蒸着、エッチング装置は3～7か月、特型装置は受注してから部品発注を行うため12か月以上となるものもある。

パワーデバイス用イオン注入装置は受注急増に伴いサプライヤーの生産能力が追い付いていない特型部品があるため、10-17か月となっている。

バッテリー向け両面蒸着巻取装置は12か月程度となっている。

11. 上期の半導体電子部品および FPD の受注高・売上高の用途別内訳、品目別の営業利益率の順位は？

A: 別紙のとおり。

以上

別紙：品目別内訳割合・営業利益率順位

●受注高 品目別の内訳割合

受注高	24/6期 上期
半導体電子（億円）	489
・メモリ	1割半ば
・ロジック	1割強
・電子部品	2割強
・パワー半導体	4割強
・実装	1割弱
・その他	-
FPD（億円）	308
・LCD	2割弱
・OLED	3割強
・バッテリー	4割半ば
・その他	数%

●売上高 品目別の内訳割合

売上高	24/6期 上期
半導体電子（億円）	420
・メモリ	2割強
・ロジック	1割半ば
・電子部品	3割弱
・パワー半導体	3割強
・実装	1桁台半ば
・その他	-
FPD（億円）	258
・LCD	4割半ば
・OLED	3割強
・バッテリー	約2割
・その他	一桁台半ば

●営業利益率順位 24/6期 上期

順位	品目
1	コンポーネント
2	一般産業
3	半導体電子
4	その他
5	マテリアル
6	FPD

全社平均利益率は
 3) 半導体電子と
 4) その他との間